

贝格斯Gap Pad 2500S20导热硅胶片

产品名称	贝格斯Gap Pad 2500S20导热硅胶片
公司名称	东莞市樟木头松全电子材料经营部
价格	.00/pcs
规格参数	
公司地址	东莞樟木头镇东城四街
联系电话	86-076983819248-604 13712308769

产品详情

贝格斯bergquist gap pad 2500s20导热硅胶片

耐温：-60到+200（ ）

厚度：0.25-3.17mm

整张规格：203*406mm

颜色：淡黄色

适用范围：处理器和散热器之间

特点和好处

热传导率=2.4w/mk 超低紧固压力下的s级低热阻材料 超贴服性胶状模量 为低紧固压力下的应用设计 抗刺破，抗撕裂的增强玻璃纤维

gap pad 2500s20是额定热传导率为2.4w/mk增强的导热材料。这种材料由超柔软的填充聚合物构成，增强了易加工性，转换性，电气绝缘性和抗撕裂性。这种材料被典型的用做螺丝固定或者夹子固定的低紧固压力的应用，它的弹性特性和贴服性能决定了其优良的界面润湿特性，从而保持高度粗糙的或者平整界面一致。gap pad 2500s20在装配的过程中两边用螺丝钉自然固定，从而固定其位置。材料的两边都有保护衬垫保护。

典型应用

处理器和散热器之间、图形芯片和散热器之间、硬盘，dvd，cdrom电子冷却、需要传热的框架，底盘或者其它需要热转移的区域。